



2023年12月22日

各 位

会 社 名 株式会社フルヤ金属
代表者名 代表取締役社長 古 屋 堯 民
(コード番号：7826)
問合せ先 取締役管理本部長 榊 田 裕 之
電 話 03-5977-3377

第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

2023年11月16日開催の取締役会において決議いたしました三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数	154,000株
	(発行予定株式数 156,000株)
(2) 払込金額の総額	1,341,432,400円
	(1株につき 金8,710.60円)
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 670,716,200円
	増加する資本準備金の額 670,716,200円
(4) 申込期間(申込期日)	2023年12月25日(月)
(5) 払込期日	2023年12月26日(火)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は2023年11月16日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。当該第三者割当増資の内容等については、2023年11月16日付「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び2023年11月27日付「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	8,309,212株	(2023年12月22日現在)
今回の増加株式数	154,000株	
増資後の発行済株式総数	8,463,212株	

ご注意: この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 1,334,432,400 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された今回の一般募集の手取概算額 9,041,866,400 円と合わせ、手取概算額合計 10,376,298,800 円について、1,800,000,000 円を 2025 年 6 月末までに土浦工場における水電解装置向け触媒(※1) 量産設備の増設及び土浦工場の稼働率向上に資する工場構内設備に係る設備投資資金に、3,700,000,000 円を 2026 年 6 月末までに千歳工場における半導体装置向け熱電対(※2) 量産設備の増設及びそれに伴う工場構内設備に係る設備投資資金に、3,500,000,000 円を 2026 年 6 月末までにつくば工場におけるターゲット(※3) 等の当社薄膜事業の主要製品量産設備の増設及びそれに伴う工場構内設備、当社電子事業におけるパワー半導体向け GaN 結晶育成用貴金属大型ライナー(※4) の製造強化に資する工場構内設備並びに当社サーマル事業におけるリフレクター量産設備の設置に係る設備投資資金に、残額を 2025 年 6 月末までに上記設備投資による増産に伴う生産工程に必要となるプラチナグループメタル(イリジウム・ルテニウム等) の調達資金に充当する予定であります。

上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。

- ※1 純水から水素を製造する PEM (Polymer Electrolyte Membrane : 固体高分子電解質膜) 法の電極材料として使われる貴金属材料です。
- ※2 半導体の酸化工程における拡散炉の精密な温度制御用に使用される温度測定用製品です。
- ※3 ハードディスクドライブ等の電子部品、磁気記録媒体及びディスプレイの薄膜形成に使用される高純度ないし合金の貴金属板材です。
- ※4 GaN (窒化ガリウム) は高耐圧性を活かしてパワー半導体での利用が期待されていますが、GaN 結晶を育成する製造設備のライニング(内張り)材として、当社ライナー製品が利用されております。

当社グループの設備投資計画の内容につきましては、2023 年 11 月 16 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意: この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。